## УДК 538.971, 53.097 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПЛЕНКЕ NaAu,

М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин

ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 Lapushkin@ms.ioffe.rssi.ru

Аннотация: Исследованы процессы, протекающие в полупроводниковой пленке *NaAu<sub>y</sub>* под действием внешнего электрического поля. Предложена модель, опирающаяся на свойства дырочной и электронной проводимости полупроводника. *Ключевые слова: адсорбция, щелочные металлы, золото, интерметаллические соединения, термическая десорбция атомов и ионов, поверхностная ионизация.* 

середине прошлого века было обнаружено существование В интерметаллических соединений золото-щелочной металл, которые как было показано позднее на примере CsAu могут быть широкозонными полупроводниками. В отличии от большинства соединений золота в соединениях золото-щелочной металл золото выступает в роли аниона [1], тогда как в абсолютном большинстве соединений золото является катионом. Ряд соединений  $Me_xAu_y$  (Me – щелочной металл) могут быть ионными полупроводниками (кроме соединений лития). При этом современные расчеты [2-5] показывают, что соединения Ме, Аи, состоят не из ионов  $Me^+$  и  $Au^-$ , а представляют собой сложную суперпозицию электронной плотности, распределенной между остовами атомами золота и атомами щелочного металла. Так, например расчеты электронной структуры NaAu<sub>5</sub> [4] и NaAu [3] показывают, что происходит сложное перераспределение электронной плотности валентных электронов с их концентрацией в области связи между атомами Na и Au. Проведенные оценки показывают, что наблюдается избыток электронной плотности вблизи Аи в области связи ~0,6÷0,7е (е – заряд электрона), что означает дефицит электронной плотности около атома натрия, равный 0,6-0,7е. Количество избыточной электронной плотности на атоме золота уменьшается с уменьшением числа атомов Na в соединении, так на один атом Au в соединении NaAu, приходится 0,14e, в соединении NaAu -0,30е. Валентная зона полупроводника сформирована Аи 5d и Аи 6s состояниями.

Настоящая работа продолжает цикл работ по исследованию процессов формирования ультратонких пленок полупроводника  $Me_xAu_y$  при высоких температурах [6-10], а также по изучению влияния внешних воздействий, таких как внешнее электрическое поле, световое воздействие

и радиационное облучение на характер процессов происходящих внутри и на поверхности ультратонких пленок [7-13]. Основными механизмами, определяющими эмиссионные свойства полупроводниковой пленки в этих работах, считались ионная проводимость полупроводника и поверхностная ионизация (ПИ). Предполагалось, что одновременно с созданием полупроводниковой пленки при высоких температурах происходит частичное разрушение сплава, а именно распад Ме, Аи, с переходом электрона от щелочного металла к остовым атомам золота, образование ионов щелочного металла и локализация электрона на группе атомов щелочного металла отрицательный заряд могут золота. Ион И разнонаправлено независимо друг от друга диффундировать внутри пленки, определяя диффузионные процессы обмена частиц и зарядов между поверхностью и объемом пленки. Десорбция с поверхности частиц рассматривалась в рамках представлений ПИ, а именно слет ионов определялся концентрацией щелочного металла на поверхности и работой выхода поверхности [14]. В рамках этой модели рассматривалось влияние внешних факторов на концентрацию и распределение ионов в пленке, на диффузионные процессы. При этом поверхностная концентрация щелочного металла, в отличие от классических представлений ПИ, определялась не только балансом адсорбции и десорбции частиц с поверхности, но и обменом частицами между поверхностью и объемом пленки. Однако в рамках этой модели игнорировалась вероятность образования в полупроводниковой пленке проводимости другого типа, а проводимости, обеспеченной n И носителями заряда. именно р при Действительно полупроводнике В высоких температурах определяющей является проводимость собственных носителей заряда. В силу малой массы эти носители более подвержены таким внешним воздействиям, как внешнее электрическое поле, их создание может стимулировать освещение и электронное облучение. Таким образом нет никаких оснований не принимать в рассмотрение возможность влияния этого механизма на процессы, наблюдаемые для эмиттеров, покрытых полупроводниковой пленкой Ме<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>.

В работах [7-10] было изучено влияние электрического поля на десорбцию ионов с поверхности пленки NaAu, которое объяснялось в рамках модели влияния электрического поля на диффузионные процессы ионов натрия в пленке. В настоящей работе исследовано влияние внешнего электрического поля на ток ионов натрия, десорбирующихся с поверхности интерметаллида  $NaAu_{v}$ ИХ термической пленки при десорбции, и предпринята попытка обоснования наблюдаемых процессов с

позиций механизма проводимости за счет образования пар *n* и *p* носителей.

Напыление атомов *Na* производили на поверхность золотой ленты с чистотой 99,99. Предварительно ленту прогревали 10 часов в вакууме при T = 1100 К и не менее 30 часов в атмосфере кислорода при давлении  $2.10^{-6}$  Торр. Эксперименты проводили при температуре ленты в пределах 700 <  $T_t$  < 1200 К в потоке натрия  $I = 10^{12} \div 10^{14}$  см<sup>-2</sup> с<sup>-1</sup>. Такая методика позволяет сформировать на поверхности золотой ленты ультратонкую пленку *NaAu*, толщиной несколько десятков атомных слоев и более. Предполагается, что формирования слоя находится на начальных стадиях, при которых y > 2 и может принимать не целые значения. Такое написание формулы соединения отражает тот факт, что у нас образуется соединение с дефицитом натрия. Это подтверждается фазовой диаграммой [15], из которой следует, что при T ~ 1000 К невозможно получить соединения в твердой фазе с большим содержанием Na, чем в NaAu<sub>2</sub>. Полученная пленка обладает высокой термической стабильностью в течение десятков часов при T = 1250 К при сохранении своих уникальных физикохимических свойств. Опыты проводили в основном в атмосфере кислорода при давлении при 1÷1,5·10<sup>-6</sup> Торр с целью предотвращения накопления на поверхности эмиттера углеродных образований. К эмиттеру можно было прикладывать электрическое поле с напряженностью электрического поля *E* < 1000 В/см. Направление вектора электрического поля могло меняться на 180°, обеспечивая либо режим вытягивания положительных ионов, образующихся на поверхности эмиттера, (тянущее поле), либо «запирания» поверхности, препятствуя ИХ на т.е. десорбции положительных ионов с поверхности (запирающее поле).

Для определения влияния электрического поля на эмиссионные свойства ультратонкой пленки  $NaAu_y$  на поверхности золотой ленты, покрытой плёнкой сплава  $NaAu_y$ , на нее направлялся поток атомов Na не более  $v = 10^{12}$  атом/см<sup>2</sup> в тянущем и запирающем электрическом поле напряжённостью  $E_d = 125$  В/см и измерялся поток ионов  $Na^+$  при T = 1150 К.

Включение тянущего электрического поля приводит появлению тока эмиссии положительных ионов натрия I(t). После достижения ионным током стационарного значения  $I_{st}$  в момент времени t=10 с включали задерживающее поле, что приводило к прекращению ионного тока. После выдержки системы в запирающем поле в течение времени  $\Delta t = 2 \div 1024$  с при продолжении напыления потока атомов натрия на поверхность включалось тянущее поле. Включение тянущего поля после экспозиции в запирающем поле за время  $\Delta t$  приводило к резкому всплеску тока  $Na^+$ . Так, например, включение тянущего поля при t = 710 с приводит к возрастанию ионного тока до значений в 2 раза превышающих  $I_{st}$ . Кинетика достижения максимального значения тока определялась постоянной времени регистрирующей аппаратуры. С момента достижения максимального значения с под до минимума, а затем постепенный рост до  $I_{st}$ . Величина всплеска ионного тока, глубина минимума и время достижения  $I_{st}$  зависели от  $\Delta t$  и  $E_d$ .

Рассмотрим происходящие при этом процессы. В предварительно созданном полупроводниковом слое *NaAu*, на *Au* при больших температурах T = 1150 К можно с большой долей уверенности считать, что происходит образование дырок и электронов. При этом концентрация дырок и электронов одинакова. В стационарных условиях наблюдается равновесное распределение положительных зарядов  $\rho_+(z)$  дырок, z – координата по нормали от поверхности вглубь слоя, и электронов  $\rho_{-}(z)$  в слое *NaAu*, Включение тянущего поля приводит к движению дырок и действием электронов под внешнего электрического поля В полупроводнике, приводя к увеличению  $\rho_{+}(z)$  вблизи поверхности, а  $\rho_{-}(z)$  на границе раздела металл/полупроводник и изгибу зон на границах полупроводникового слоя. Дошедшая до границы раздела NaAu<sub>y</sub> / вакуум дырка может принимать участие В поверхностной ионизации десорбирующегося натрия, за счет повышения эффективности его ионизации при нейтрализации дырки валентным электроном атома Na и образовании иона *Na*<sup>+</sup>.

Включение запирающего поля приводит к перераспределению пространственного распределения  $\rho_+(z)$  и  $\rho_-(z)$  в слое  $NaAu_v$  под внешнего электрического действием поля. Дырки будут концентрироваться в области границы раздела металл / NaAu, а электроны в области границы раздела NaAu, / вакуум. Кроме того, включение запирающего поля приводит к росту концентрации натрия на поверхности слоя. Увеличение концентрации натрия на поверхности при запирающем слое обусловлено, во-первых, за счет прекращения десорбции ионов  $Na^+$ , за во-вторых, счет образования дополнительных локальных a, в виде локализованных на поверхности адсорбционных центров электронов. Это увеличение концентрации натрия на поверхности может происходить до достижения нового равновесного покрытия.

Подача вытягивающего поля после запирающего приводит к открытию канала десорбции ионов натрия и к ликвидации дополнительных

адсорбционных центров, за счет оттягивания электронов их образующих или к их нейтрализации дырками в тянущем ионы поле. Это приводит к вспышки ионного формированию тока сразу после включения вытягивающего Паление тока обеспечено напряжения. ионного уменьшением концентрации натрия на поверхности. Последующий постепенный рост ионного тока до стационарного значения *I*(*t*) связан с постепенным нарастанием концентрации дырок около границы раздела *NaAu*, / вакуум и, следовательно, увеличением эффективности ионизации десорбирующегося натрия. Электроны постепенно концентрируются на границе металл / *NaAu*,

Изменение ионного тока I(t) при подаче вытягивающего поля (в момент t = 710 с на рис. 1) можно описать двумя экспонентами: возрастающей и спадающей. Возрастающая экспонента отражает процессы восстановления распределения положительных зарядов  $\rho_+(z)$  искаженного подачей запирающего поля.



Рис. 1. Зависимость тока ионов  $Na^+$  от времени при включении запирающего поля на 700 с.

Спадающая же экспонента отражает сумму процессов: уменьшение концентрации натрия на поверхности, за счет включения канала десорбции ионов; увеличение эффективности ионизации натрия за счет всплывания дырок на поверхность; увеличение работы выхода  $\varphi$  при уменьшении концентрации частиц на поверхности. Последнее обусловлено тем, что для металлов и полупроводников наблюдается линейная зависимость

изменения работы выхода  $\varphi$  от покрытия поверхности щелочным металлом [16]. В нашем случае зависимость  $\varphi(t)$  отражает временную зависимость  $\varphi$  от концентрации адсорбата, изменяющуюся со временем. Количество адсорбированных атомов натрия N(t) на поверхности после подачи вытягивающего поля определяется суммой накопленных за время действия запирающего поля атомов  $N_0$ , дополнительным количеством адсорбирующихся атомов за счет потока атомов натрия на поверхность a(t) и слетающим атомами и ионами n(t) за время t за счет механизма ПИ:

$$n(t) = \int_{0}^{t} \left[ \left( N_0 + a(t) \right) (1 - \beta_0) e^{-\frac{\varphi(t) - V}{kT}} \right] \beta_+ dt, \qquad (1)$$

где k – постоянная Больцмана, V – потенциал ионизации атома Na,  $\beta_+, \beta_0$  – вероятность слета ионов и атомов, соответственно. Тогда для N(t) можно записать:

$$N(t) = (N_0 + a(t))(1 - \beta_0) - \int_0^t \left[ (N_0 + a(t))(1 - \beta_0)e^{-\frac{\varphi(t) - V}{kT}} \right] \beta_+ dt.$$
(2)

Тогда для числа слетающих ионов образовавшихся в процессе ПИ можно написать следующее уравнение:

$$I(t) = \left[ \left( N_0 + a(t) \right) (1 - \beta_0) - \int_0^t \left[ \left( N_0 + a(t) \right) (1 - \beta_0) e^{-\frac{\varphi(t) - V}{kT}} \right] \beta_+ dt \right] \beta_+ e^{-\frac{\varphi(t) - V}{kT}}.$$
 (3)

При написании уравнения считалось, что теплоты слета ионов и атомов с поверхности не изменялись во времени.

Площадь «вспышки»  $S(\Delta t)$  ограничена участком роста ионного тока и спадающей экспоненциальной зависимостью, которая пропорциональна количеству атомов Na, накопленного за время подачи запирающего напряжения. По площади вспышки можно оценить количество вылетевших ионов за время вспышки и соответственно оценить количество слетевших ионов натрия. Площадь под кривой  $I(t_d)$  от  $t_d = 710$ до  $t_d = t_{st} = 1140$  с обозначим как площадь «вспышки»  $S(\Delta t)$ . Тогда для времени задержки  $\Delta t = 700$  с за время вспышки с поверхности вылетает порядка 8·10<sup>12</sup> ионов/см<sup>2</sup>, что приводит к формальному покрытию ионов ~0,015 монослоя (монослой атомов натрия составляет величину 5·10<sup>14</sup> атомов/см<sup>2</sup>). При этом за первую секунду вспышки слетает до 10% всех десорбирующихся ионов. процентов Зависимость площади «вспышки» от времени  $\Delta t$  действия запирающего поля  $E_d$  приведена на рис. 2.

Видно, что максимальное количество накопленного атомов Na на

поверхности при величине запирающего поля V = 125 В наблюдается при  $\Delta t = 75$  с. Падение  $S(\Delta t)$  после максимума связано с большим покрытием *Na* на поверхности при этих временах запирания. То есть, начиная с этого покрытия дальнейшее его увеличение, приводит к уменьшению работы выхода поверхности и, следовательно, к уменьшению вероятности ионизации атомов *Na* на поверхности *NaAu<sub>y</sub>*. Уравнение (3) достаточно хорошо описывает наблюдаемые в эксперименте процессы. Отметим также, что на все вышеуказанные процессы могут также влиять: диффузия *Na* вглубь пленки с его включением в сплав *NaAu<sub>y</sub>*; образование и диффузия ионов *Na*<sup>+</sup>.



Рис. 2. Зависимость площади вспышки от времени запирания.

Предложена новая модель процессов, происходящих в тонких пленках  $NaAu_y$ , выращенных на поверхности Au, под действием внешнего электрического поля. Показана роль собственных носителей заряда в пленке  $NaAu_y$  на процессы отклика пленки на воздействие внешнего электрического поля и роль дырок на процесс ионизации атомов Na на поверхности  $NaAu_y$ .

## Библиографический список:

1. Jansen, M. The chemistry of gold as an anion / M. Jansen // Chemical Society Reviews. 2008. – V. 37. – I. 9. – P. 1826-1835.

2. Aycibin, M. Physical properties of *RbAu* compound / M. Aycibin, E. K. Dogan, S.E. Gulebaglan, M. N. Secuk, B. Erdinc, H. Akkus // Computational Condensed Matter. – 2014. – V. 1. – P. 32-37.

3. Grosch, G.H. Chemical trends in gold alkali alloys: A density functional theory study on stability and charge transfer Part I: Gold alkali alloys of the formula MAu / G.H. Grosch, K.-J. Range // Journal of Alloys and Compounds. – 1996. – V. 233. – I. 1-2. – P. 30-38.

4. Grosch, G.H. Chemical trends in gold alkali alloys: A DFT- study on stability and charge transfer Part I: Gold alkali alloys of the formula  $MAu_5$  / G.H. Grosch, K.-J. Range // Journal of Alloys and Compounds. – 1996. – V. 233. – I. 1-2. – P. 39-43.

5. **Kwolek, E.J.** The (111) Surface of  $NaAu_2$ : Structure, Composition, and Stability / E.J. Kwolek, R. Widmer, O. Gröning, O. Deniz, H. Walen, C.D. Yuen, W. Huang, D.L. Schlagel, M. Wallingford, P.A. Thiel // Inorganic Chemistry. – 2015. – V. 54. – I. 3. – P. 1159-1164.

6. Зандберг, Э.Я. Фотостимуляция диффузии атомов щелочных металлов в приповерхностных слоях золота / Э.Я. Зандберг, М.В. Кнатько, В.И. Палеев, И.Д. Пелехатый, М.М. Сущих // Письма в Журнал технической физики. – 1995. – Т. 21. – Вып. 19. – С. 15-20.

7. **Кнатько, М.В.** Управление термической ионизацией с помощью электропереноса катионов целочных металлов / М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев // Письма в Журнал технической физики. – 2005. – Т. 31. – Вып. 8. – С. 19-23.

8. Кнатько, М.В. Особенности термостимулированной десорбции ионов *Na<sup>+</sup>* и *Cs<sup>+</sup>* с пленки сплава *NaAu* на *Au* / .В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев // Журнал технической физики. – 2005. – Т. 74. – Вып. 4. – С. 109-113.

9. Кнатько, М.В. Влияние электрического поля на эмиссию ионов *Na* из поверхностного сплава *NaAu* / М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин // Известия РАН. Серия физическая. – 2013. – Т. 77. – №. 3. – С. 379-382.

10. Кнатько, М.В. Пороговые процессы эмиссии ионов натрия из поверхностного сплава *NaAu* / М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин // Письма в Журнал технической физики. – 2015. – Т. 41. – Вып. 8. – С. 43-49.

11. Агеев, В.Н. Начальные стадии взаимодействия натрия и цезия с золотом / В.Н. Агеев, Е.Ю. Афанасьева // Физика твердого тела. – 2006. – Т. 48. – Вып. 12. – С. 2217-2222.

12. Ageev, V.N. Electron-stimulated desorption of cesium atoms from cesium layers adsorbed on gold-covered tungsten / V.N. Ageev, Yu.A. Kuznetsov, N.D. Potekhina // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2010. – V. 22. – I. 8. – P. 084005-1-084005-9.

13. Агеев, В.Н. Использование электронно-стимулированной десорбции в изучении адсорбированных слоев / В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина // Журнал технической физики. – 2013. – Т. 83. – Вып. 6. – С. 85-91.

14. Зандберг, Э.Я. Поверхностная ионизация / Э.Я. Зандберг, Н.И. Ионов. – М.: Наука, 1969. – 432 с

15. **Pelton, A.D.** The Au - Li (Gold-Lithium) system / A.D. Pelton // Bulletin of Alloy Phase Diagrams. -1986. - V. 7. - I. 3. - P. 228-231.

16. Фоменко, В.С. Эмиссионные свойства металлов материалов / В.С. Фоменко. – Киев: Наукова Думка, 1981. – 340 с.